

电子行业

2025年7月13日

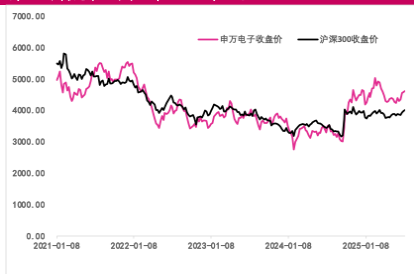
行业周度点评报告

—AI 与先进封装驱动 ABF 载板市场扩张，关注国产替代投资机会

评级：增持（维持）

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
新亚电子	24.51	31.85	79.49
*ST 宇顺	19.23	21.71	53.89
金安国纪	13.64	20.28	99.30
东田微	58.06	16.96	46.45
乐鑫科技	154.33	12.54	241.84
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
瑞联新材	38.29	-15.98	66.46
中京电子	13.39	-13.78	82.03
宝明科技	59.91	-13.64	109.06
南亚新材	40.99	-11.85	97.75
好上好	30.81	-11.49	91.46

行业指数相对沪深 300 表现



相关报告

【金元电子】周报 20250607 英伟达 B30 中国特供芯亮相，H20 六折定价卡位国产芯片

【金元电子】周报 20250615 火山引擎加速 AI 商业化，关注算力基础设施、端侧智能硬件及 AI 应用三大赛道

【金元电子】周报 20250621 关注下半年中国半导体设备国产替代投资机会

【金元电子】周报 20250628 小米 YU7 预售 28.9 万台破纪录+首款 AI 眼镜亮相，双产品线引爆市场

【金元电子】周报 20250705 苹果首款折叠屏手机已进入原型试产阶段，聚焦折叠屏产业链投资机会

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangrj@jyzq.cn

● **全行业：**本周（2025.07.07-2025.07.11）上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.78%，沪深300指数上涨0.82%，申万电子板块上涨0.93%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为24/31。板块个股涨幅前五名分别为：新亚电子、*ST宇顺、金安国纪、东田微、乐鑫科技；跌幅前五名分别为：瑞联新材、中京电子、宝明科技、南亚新材、好上好。

● **电子行业：**本周（2025.07.07-2025.07.11）国内电子行业整体延续普遍上涨态势。光学光电子板块涨幅居前，达1.34%，其中面板和光学元件分别上涨1.52%和1.48%，LED也表现稳健，上涨0.79%。半导体板块整体上涨1.07%，分立器件和半导体材料领涨，涨幅分别为3.10%和1.77%，数字芯片设计、模拟芯片设计和集成电路封测涨幅相近，在0.76%-0.96%之间，半导体设备微涨0.19%。消费电子板块上涨0.89%，消费电子零部件及组装表现优于品牌消费电子，涨幅分别为0.96%和0.33%。电子化学品板块上涨0.72%，三级行业同步波动。元件板块涨幅为0.27%，印制电路板上涨0.62%，但被动元件下跌1.01%。其他电子板块微涨0.11%，三级行业走势一致。总体来看，电子行业各细分领域普遍呈现温和上涨趋势，光学光电子和半导体中的分立器件表现尤为突出。

行业要闻

- ◆ 英特尔AI Summit SK海力士登台，新一代AI加速器受瞩目
- ◆ 瑞萨双线进攻AI市场，MCU、GaN效能与成本双优化
- ◆ IBM推最新Power11晶片，有助简化AI部署
- ◆ 传苹果正在开发七款自研晶片
- ◆ 冲破DeepSeek、关税挑战，NVIDIA市值破4兆美元

公司动态：

- ◆ 中微半导体：2024年年度权益分派实施公告
- ◆ 至纯科技：2024年年度权益分派实施公告
- ◆ 睿能科技：睿能科技2024年年度权益分派实施公告
- ◆ 沃格光电：沃格光电2024年年度权益分派实施公告
- ◆ 鼎龙股份：2024年度权益分派实施公告

● **投资建议：**我们认为，随着AI、自动驾驶、数据中心和AR/VR设备的发展，高性能芯片需求将大幅增加，ABF载板作为先进封装的关键材料，市场需求将持续增长。中国ABF载板市场国产化进程加速，国家大基金二期推动FC-BGA产线建设，投资者可关注在国产化进程中受益的企业。

● **风险提示：**国产化进程的不确定性、原材料供应风险、政策和国际贸易风险、市场需求波动风险。

目 录

一、核心观点..... 3

二、行业跟踪..... 4

三、行业新闻..... 7

四、公司公告..... 12

五、下周投资提示..... 15

图表目录

图 1：全球 IC 载板市场未来几年稳步增长 3

图 2：全球 ABF 市场规模（亿美元） 3

图 3：本周各行业版块涨跌幅 5

图 4：本周电子版块：子版块涨跌幅 6

图 5：电子版块历史走势 7

图 6：电子版块历史市盈率 7

表 1：2021-2023 ABF 载板供应商市场份额..... 3

表 2：本周电子版块个股涨幅前五名 5

表 3：本周电子版块个股跌幅前五名 5

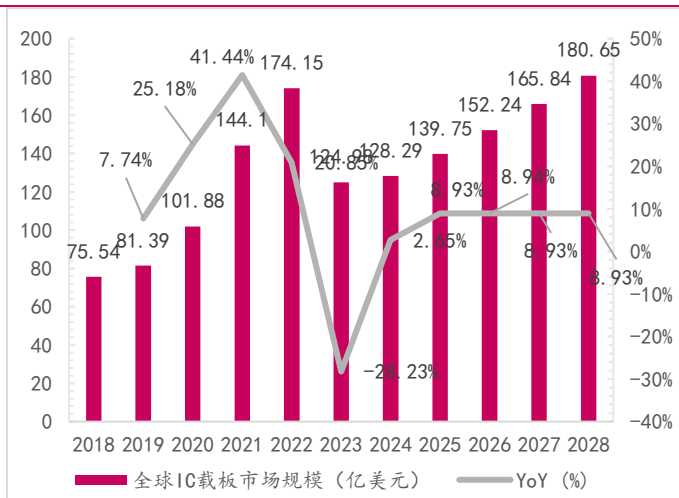
表 4：下周重要会议..... 15

表 5：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股） 16

一、核心观点

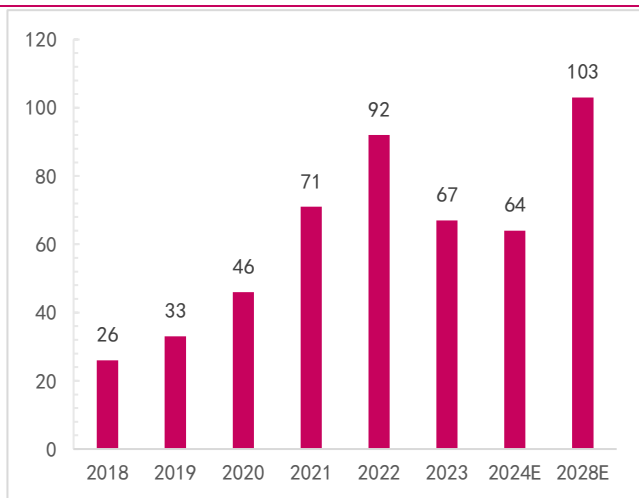
先进封装推动 IC 载板快速迭代升级，ABF 载板市场规模有望迎来快速增长。未来随着 AI/自动驾驶等产业发展，将会推动高性能芯片需求增长，由于摩尔定律受限影响，先进封装将成为推动芯片性能提升的主要路径，ABF 载板作为先进封装的标配材料，其层数、尺寸和精细度将会随着芯片复杂度提升而逐步提高，预计 ABF 载板将会迎来量价齐升的黄金成长期。

图 1：全球 IC 载板市场未来几年稳步增长



数据来源：臻鼎科技集团官网，金元证券研究所

图 2：全球 ABF 市场规模（亿美元）



数据来源：臻鼎科技集团官网，金元证券研究所

ABF 载板市场呈寡头集中格局，主要由日本揖斐电、新光电气，中国台湾欣兴电子、南亚电路板，韩国三星机电占据全球 87% 以上市场份额。据核芯产业观察统计，前三大厂商欣兴电子、揖斐电、南亚电路板市占率超 49%。技术上，国际企业已实现 8-16 层高叠层、5 μ m 线宽/线距的 ABF 载板量产，支持 CoWoS、InFO 等先进封装工艺。随着 AI、数据中心、汽车电子推动国内 ABF 载板需求，目前 ABF 载板在 CPU、GPU、AI 芯片封装中占比超 50%，支撑数据中心和自动驾驶需求。AR/VR 设备对高密度封装的需求也推动 ABF 在传感器、存储器中的应用。

表 1：2021-2023 ABF 载板供应商市场份额

排名	载板供应商	2021	2022	2023
1	欣兴电子	15.4%	18.5%	16.9%
2	揖斐电	12.8%	10.2%	11.6%
3	三星机电	10.1%	9.3%	10.5%
4	南亚电路板	10.2%	10.5%	9.3%
5	神钢电机	8.3%	7.2%	6.1%
6	景硕科技	6.6%	6.8%	5.2%
7	LG 伊诺特	5.0%	4.7%	4.9%
8	大德电子	4.0%	4.8%	4.9%
9	AT&S	3.7%	4.1%	4.7%

10	信泰电子	6.3%	5.8%	4.6%
Top 10 合计		82%	82%	79%

数据来源：深芯盟，金元证券研究所

技术创新驱动下的中国 ABF 载板国产化加速发展。核芯产业观察消息显示，2023 年中国大陆 ABF 载板产能仅占全球 7.2%，主要来自奥特斯的重庆工厂，其余厂商如深南电路、兴森科技处于量产爬坡阶段。到 2024 年 ABF 载板国产化率仅 4%，2025 年预计提升至 5%，其中高端基板仍不足 20%。而韩国的东进世美肯公司推出替代材料 DJBF，CTE 和 Df 已达到或超越 ABF 水平，国内企业有望加速跟进。在 2024 年日本升级半导体材料出口管制后，国内加速推进 ABF 国产化，国家大基金二期重点支持 FC-BGA 产线建设。

投资建议：我们认为，随着 AI、自动驾驶、数据中心和 AR/VR 设备的发展，高性能芯片需求将大幅增加，ABF 载板作为先进封装的关键材料，市场需求将持续增长。中国 ABF 载板市场国产化进程加速，国家大基金二期推动 FC-BGA 产线建设，投资者可关注在国产化进程中受益的企业。

风险提示：

1、国产化进程的不确定性：

尽管国产化进程加速，但高端基板的国产化仍面临技术和产能的挑战，投资者需关注国产化进程的实际进展和效果。

2、原材料供应风险：

ABF 载板的生产依赖于进口，国际市场上原材料价格波动和供应链中断可能对生产成本和供货稳定性产生影响。

3、政策和国际贸易风险：

日本升级半导体材料出口管制可能对全球供应链产生影响，投资者需关注相关政策和国际贸易环境的变化对市场和企业的潜在影响。

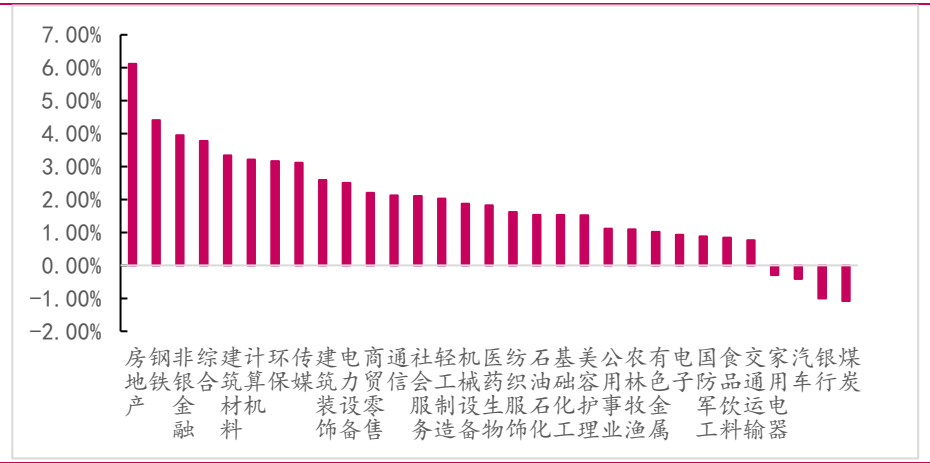
4、市场需求波动风险：

尽管 AI、自动驾驶等领域对高性能芯片的需求增长迅速，但市场需求可能受到宏观经济环境、技术进步速度等因素的影响，存在一定的不确定性。

二、行业跟踪

全行业：本周（2025.07.07-2025.07.11）上证指数上涨 1.09%，深证成指上涨 1.78%，沪深 300 指数上涨 0.82%，申万电子板块上涨 0.93%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 24/31。板块个股涨幅前五名分别为：新亚电子、*ST 宇顺、金安国纪、东田微、乐鑫科技；跌幅前五名分别为：瑞联新材、中京电子、宝明科技、南亚新材、好上好。

图 3：本周各行业版块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 2：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
605277.SH	新亚电子	31.85	24.51	18.00	26.33	100.11	314.31	72.33
002289.SZ	ST 宇顺	21.71	19.23	15.70	19.23	6.50	18.20	3.22
002636.SZ	金安国纪	20.28	13.64	10.99	16.60	66.53	481.91	68.86
301183.SZ	东田微	16.96	58.06	48.41	60.00	76.76	45.00	24.98
688018.SH	乐鑫科技	12.54	154.33	135.14	157.44	17.05	26.72	40.04

数据来源：Choice，金元证券研究所

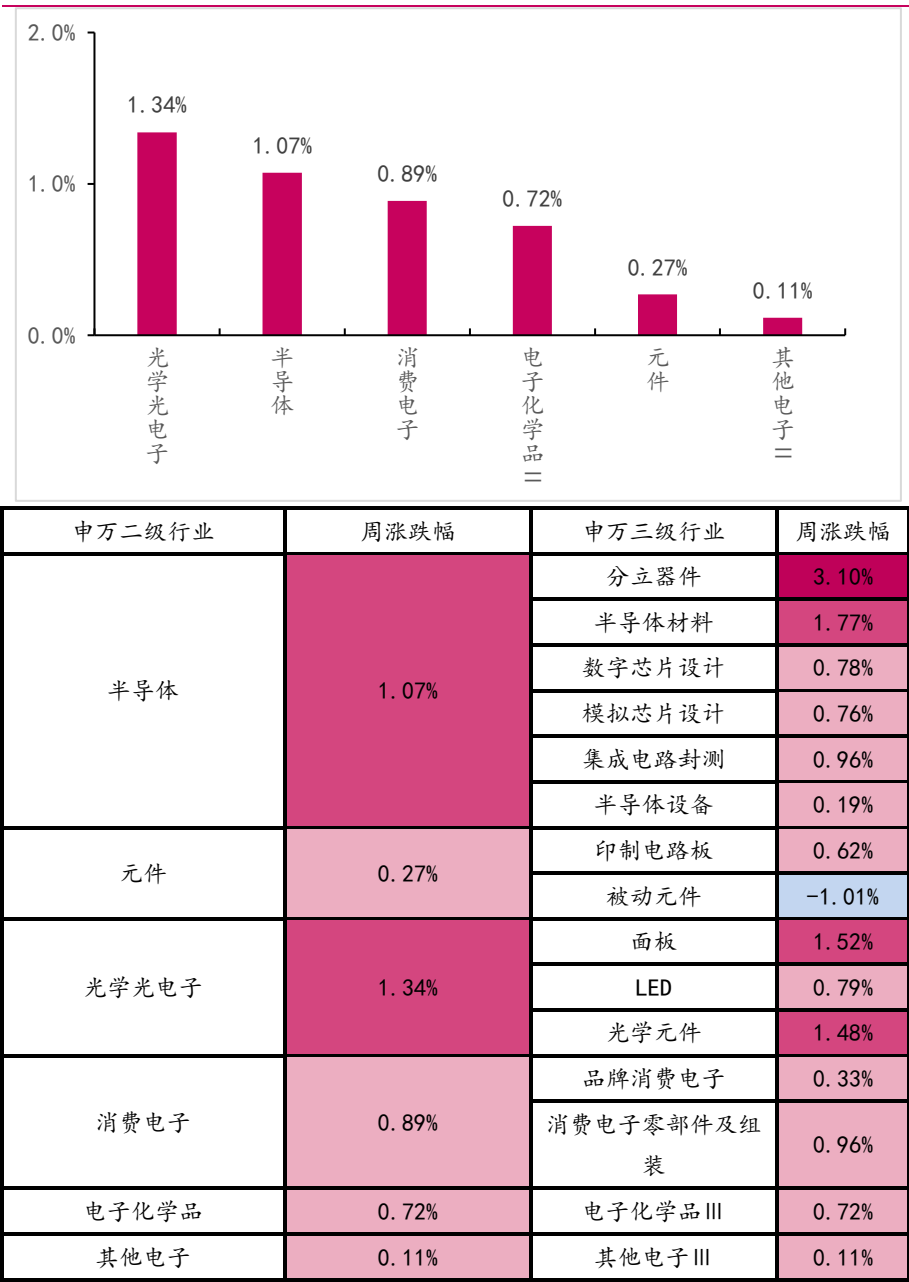
表 3：本周电子版块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
688550.SH	瑞联新材	-15.98	38.29	38.25	46.18	27.44	47.64	19.47
002579.SZ	中京电子	-13.78	13.39	12.69	16.22	161.09	936.78	137.62
002992.SZ	宝明科技	-13.64	59.91	58.99	71.45	28.18	22.51	14.53
688519.SH	南亚新材	-11.85	40.99	40.36	47.10	10.03	23.29	10.04
001298.SZ	好上好	-11.49	30.81	30.35	35.08	134.98	207.99	67.47

数据来源：Choice，金元证券研究所

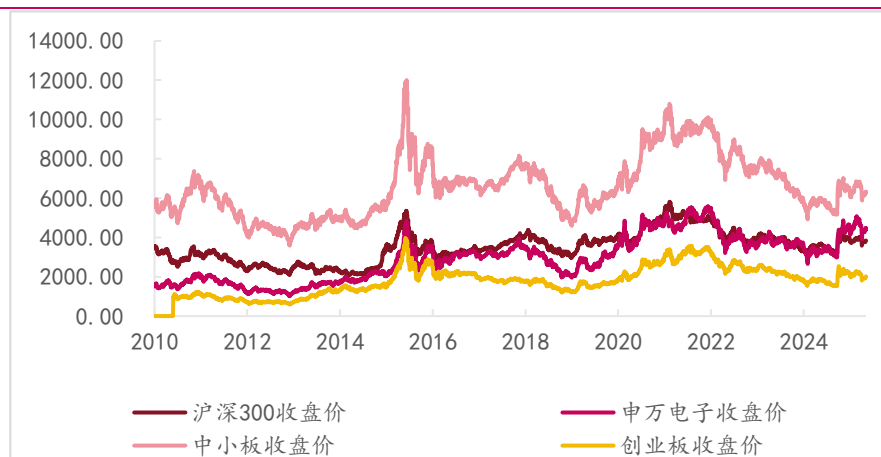
电子行业：本周（2025.07.07-2025.07.11）国内电子行业整体延续普遍上涨态势。光学光电子板块涨幅居前，达1.34%，其中面板和光学元件分别上涨1.52%和1.48%，LED也表现稳健，上涨0.79%。半导体板块整体上涨1.07%，分立器件和半导体材料领涨，涨幅分别为3.10%和1.77%，数字芯片设计、模拟芯片设计和集成电路封测涨幅相近，在0.76%-0.96%之间，半导体设备微涨0.19%。消费电子板块上涨0.89%，消费电子零部件及组装表现优于品牌消费电子，涨幅分别为0.96%和0.33%。电子化学品板块上涨0.72%，三级行业同步波动。元件板块涨幅为0.27%，印制电路板上涨0.62%，但被动元件下跌1.01%。其他电子板块微涨0.11%，三级行业走势一致。总体来看，电子行业各细分领域普遍呈现温和上涨趋势，光学光电子和半导体中的分立器件表现尤为突出。

图 4：本周电子版块：子版块涨跌幅



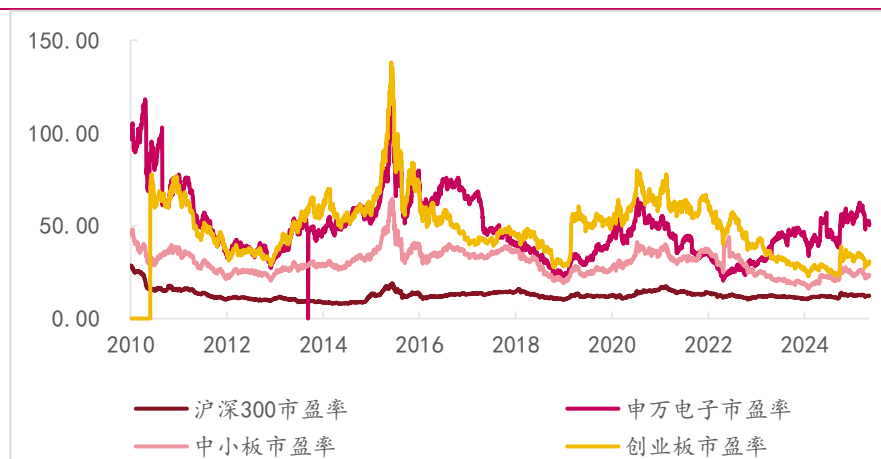
数据来源：Choice，金元证券研究所

图 5：电子板块历史走势



数据来源：Choice，金元证券研究所

图 6：电子板块历史市盈率



数据来源：Choice，金元证券研究所

三、行业新闻

英特尔AI Summit SK海力士登台，新一代AI加速器受瞩目

7月7日电电子时报消息，英特尔日前于韩国举行“AI高峰会（Intel AI Summit）”，其中SK海力士与英特尔在新一代AI加速器的高频宽记忆体（HBM）合作引发关注。SK海力士软件解决方案负责人郑佑燮于活动中表示，针对英特尔 Gaudi AI加速器产品，正进行高频宽记忆体（HBM）相关合作。有韩媒分析认为，英特尔新一代AI加速器（研发代号Jaguar Shores），将可能搭载SK海力士的第六代HBM产品HBM4。不过对此SK海力士仅表示，本公司正与多数客户、合作业者推动AI半导体领域合作。SK海力士与英特尔长期以来维持伙伴关系，目前也在多种领域进行合作。

瑞萨双线进攻AI市场，MCU、GaN效能与成本双优化

7月7日电电子时报消息，日本半导体厂瑞萨电子决定停止SiC功率半导体的量产，同时针对边缘AI、AIoT市场推出新款微控制器（MCU），并向AI资料中心推出新

款GaN功率半导体。日媒报导，瑞萨宣布已推出一款专为边缘AI设计的MCU，并于7月2日开始量产。这款新型MCU“RA8P1”采用Arm核心架构及台积电的22nm超低漏电制程技术，内建更耐久且具备高速资料传输能力的MRAM，并搭载专门处理AI的神经网络处理单元，AI推论处理效能提升30倍至每秒执行2,560亿次指令。预计将应用于驾驶员监控等ADAS、车载摄影机、感测器等需高速处理的场景。

三星2nm代工梦碎，传高通剔除名单，由台积独揽旗舰大单

7月7日科技新报消息，据外媒最新消息，高通Snapdragon 8 Elite Gen 2原计划采双供应商策略，但现已舍弃三星、由台积电独供该订单。高通Snapdragon 8 Elite Gen 2原规划两个版本，其中一款采用三星2nm制程，代号为“Kaanapali S”。但最新传闻指出，高通对于是否在Snapdragon 高峰会上公布双版本方案产生动摇，目前已将三星从代工名单中剔除，连产品辨识代码8850-S与8850-T也遭移除，目前仅剩单一版本SM8850，预计将成为Snapdragon 8 Elite Gen 2的正式名称，未来SM8850将支持各家Android旗舰机，包括原预计采用三星的Galaxy S26 系列。同时QRD (Qualcomm Reference Design) 报价也会增加。

台积电+AI 日本晶片设备销售获上修，创历史新高

7月7日科技新报消息，AI伺服器用GPU、HBM 需求旺盛，加上受惠台积电将量产2nm，日本半导体制造装置协会（SEAJ）上修2025 年度日本制半导体（晶片）设备销售额预估、将续创历史新高纪录，且预估2026年度销售额将史上首度冲破5 兆日元大关、改写历史新高。SEAJ公布预估报告指出，台积电将开始量产2nm、对应投资增加，加上韩国对DRAM/HBM的投资增加，2025年度日本制晶片设备销售额自前次（2025年1月）预估的4兆6,590亿日元上修至4兆8,634亿日元、将较2024年度增加2.0%，年销售额将连续第2年创下历史新高纪录。SEAJ表示，2026年度期间，台湾以外的企业对2nm的投资将增加、且期待日本也将对2nm进行量产投资，加上厂商对AI伺服器用HBM、NAND Flash（300层以上产品）的投资看增，因此将2026年度日本晶片设备销售额自前次预估的5兆1,249亿日元上修至5兆3,498亿日元、将年增10.0%，年销售额将史上首度冲破5兆日元大关、续创历史新高。

英飞凌12英寸氮化镓生产路线图取得进展

7月7日爱集微消息，氮化镓（GaN）半导体需求持续增长，英飞凌宣布其在12英寸晶圆上的可扩展GaN生产进度正按计划进行，预计2025年第四季度将向客户提供首批样品，有望扩大客户基础，进一步巩固在GaN的市场竞争力。英飞凌专精于三种材料的相关技术，包含硅（Si）、碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）。凭借更高的功率密度、更快的开关速度和更低的功率损耗，氮化镓半导体可实现更精简的设计，从而减少智能手机充电器、工业和人形机器人，以及太阳能逆变器等电子设备的能耗和热量产生。

NVIDIA拟投资数十亿美元在以色列建大型园区

7月8日爱集微消息，NVIDIA布局全球，除在北士科设立海外总部，也计划斥资数十亿美元在以色列北部兴建大型园区，这项计划由CEO黄仁勋拍板，并以买

地非租赁、不取代现在据点、扩大征才，显见NVIDIA扩张的企图心，预计将为当地带来庞大的经济效益与就业机会。根据以色列媒体Calcalist报导，NVIDIA发布征询资讯，希望找寻面积约7万至12万平方公尺的土地，且具备8万至18万平方公尺的连续建筑权，地点则要靠近目前位于约克尼姆（Yokneam）总部。NVIDIA仅为找土地流程预留两周时间，显见其急迫性。消息人士透露，新园区不会取代现在据点，而是扩大版图，并采取购买土地的方式进行，展现NVIDIA拥有关键房地产的策略。

3Q25新旧世代DRAM交替，合约价走势分化，消费级DDR4季增逾40%

7月8日科技新报消息，TrendForce最新调查显示，由于三大DRAM原厂将产能转向高阶产品，并陆续宣布PC、伺服器用DDR4和行动LPDDR4X进入产品生命周期末期，引发市场对旧世代产品积极备货，加诸传统旺季备货动能，将推升2025年第三季一般型DRAM价格季增10%~15%，加计HBM整体DRAM涨幅季增15%~20%。DDR4需求持续热络，原厂有意扩大售价涨幅。台厂产能尚无法完全衔接，且产品容量较小，短期DDR4仍供不应求。消费端DDR4供货有限，预计第三季价格季增40%~45%。相对产能集中的新世代DDR5产品，第三季价格涨幅相对温和，出现新旧产品世代价格走势分化的市场格局。出于关税考量，主要PC OEM皆积极要求ODM提高整机组装量，并继续提高DRAM库存水位，预估第三季PC DRAM价格涨幅将扩大至8%~13%。伺服器DRAM市场需求受资料中心、新平台与AI伺服器部署支撑，价格上涨3%~8%。

韩国减少对日本芯片材料依赖，光刻胶进口依赖度从93.2%降至65.4%

7月8日爱集微消息，韩国推动半导体必要材料的本地化生产，进展显著。包括东进世美肯、三养NC Chem和SoulBrain在内的公司已建立光刻胶、高纯度氢氟酸和聚酰亚胺的国内生产能力，从而占据专业市场领域。韩国对日本光刻胶进口的依赖度从2018年的93.2%降至2024年的65.4%，对高纯度氢氟酸的依赖度减少62.5%，金额从1.6亿美元降至6000万美元。然而，虽然韩国已成功实现湿式氢氟酸的本地化生产，但对先进光刻节点至关重要的干式氢氟酸仍然由日本控制。

传英特尔将跳级追赶台积电先进制程

7月8日爱集微消息，市场传出，英特尔新任CEO陈立武考虑对晶圆代工策略进行重大调整，最快会于7月董事会讨论是否停止向新客户推销18A，改为集中资源发展下一代14A制程，以“跳级”方式，追赶台积电更先进的制程。大型法人机构分析，英特尔的18A与14A制程，分别代表其晶圆代工蓝图中1.8nm与1.4nm世代技术节点。

Laser World of Photonics 2025开幕，全球激光巨头同台竞技

7月8日EETC消息，近日NVIDIA以4亿美元收购了位于多伦多的AI初创公司CentML。这家公司由95后华人王尚及其导师Gennady Pekhimenko共同创立，专注于优化AI应用程序的运行方式。CentML的创新技术主要集中在提高GPU利用率上，开发了HFTA技术，在提高硬件利用率方面非常有效，其训练吞吐量可提高高达15.1倍。此外，CentML还开发了Seesaw，这是一种新的推理优化技术，与目前应用最广泛的顶尖大模型推理引擎vLLM相比，Seesaw的吞吐量最高提升

1.78倍（平均提升1.36倍）。在此次收购前，NVIDIA已为CentML提供了2700万美元的种子轮融资。当时，这笔资金曾用于在2024年底前将CentML的32人团队扩大一倍。

2035年全球33%晶片生产恐面临铜供应中断

7月9日科技新报消息，PwC今天在给商界领袖的报告中指出，2035年前全球32%半导体生产恐面临气候变迁相关的铜供应中断，这个比率将是目前四倍。路透社报导，全球最大铜生产国智利目前正努力解决导致生产放缓的水资源短缺问题。PwC表示，2035年，17个晶片产业的铜供应国中，大多将面临干旱风险。上一次全球晶片短缺是因疫情引发的需求激增与工厂停工造成，当时不但汽车制造业因此陷入瘫痪，其他仰赖晶片的生产线也停摆。

西门子EDA推两大全新解方，助简化3D IC设计与分析流程

7月9日科技新报消息，西门子数位工业软件日前为EDA产品组合推出两款全新解决方案，Innovator3D IC™ 解决方案套件可协助IC设计人员高效进行异质整合式2.5D/3D-IC设计的开发、仿真与管理，新款Calibre 3D Stress 软件则利用先进的热机械分析来辨识应力在电晶体层级造成的电性影响。搭配应用两款解决方案可显著降低下一代2.5D/3D IC 复杂的设计风险，并提高设计品质、良率与可靠性。全新的Innovator3D IC解决方案套件为异质设计的规划和整合、基板/中介层实作、介面协定分析合规性，以及设计和IP的资料管理提供快速、可预测的路径。

盼顺利重整，碳化矽厂Wolfspeed 7月股价暴涨470%

7月9日科技新报消息，碳化矽（SiC）材料领导厂商Wolfspeed, Inc. 宣布任命Gregor van Issum 担任CFO，9月1日生效，股价闻讯暴冲。Wolfspeed 7日通过新闻稿指出，Van Issum在科技产业拥有超过20年的转型重整、策略性融资经验，曾在欧司朗光电半导体（ams-OSRAM）担任执行副总裁兼集团监督，也曾于恩智浦半导体（NXP Semiconductors）的安全交易与辨识解决方案部门担任策略副总裁。

联发科携手NVIDIA开发新芯片

7月9日爱集微消息，联发科布局个人AI超级电脑迈入收成期，与NVIDIA共同开发、用于NVIDIA首款个人AI超级电脑的GB10超级芯片，获得主要PC品牌大厂青睐，本月起相关终端产品陆续上市开卖，联发科GB10超级芯片也将进入大量出货阶段。NVIDIA规划，要推出全世界体积最小的AI超级电脑“Project DIGITS”，由联发科与NVIDIA共同开发的GB10超级芯片。联发科指出，GB10架构在NVIDIA Grace Blackwell平台，可为AI与云端科技生态带来突破性变革。

三星电子将回购价值3.9万亿韩元的股票

7月9日爱集微消息，三星电子于7月8日披露，决定在9月9日至10月8日期间通过市场购买方式回购56,888,092股普通股和7,834,553股其他类型股份。预计回购总金额达3.9119万亿韩元，其中普通股部分为3.51万亿韩元，其他类型股份部分为4019亿韩元。本次回购的库存股将专项用于：员工年度绩效激励

(OPI)、高管长期业绩奖励 (LTI) 及未来核心人才激励。具体限售条款将在各股权激励方案实施时另行披露。三星电子计划注销价值2.8119万亿韩元的股份，以提升股东价值，剩余1.1万亿韩元将用于员工奖金及其他用途。

CoPoS掀面板级封装新主流，传意法半导体抢搭设备顺风车

7月10日电子时报消息，强调 “以圆代方” 的新面板级封装 (PLP) 技术以低成本优势展露头角，年初时台积电传出将以 “类CoWoS” 技术切入大尺寸封装领域，近期更传出意法半导体也正在洽询购入相关设备。意法半导体的法国图尔厂将新增面板级封装业务，成为小晶片技术发展和复杂半导体应用的关键。业界人士表示，台积电推出的非晶圆级先进封装技术CoPoS采取将晶片直接封装至玻璃基板上的解决方案，以进一步实现更大的封装尺寸，并提升多晶片异质整合的性能，满足客户更复杂的晶片设计需求。不过，现阶段解决玻璃面板的翘曲问题是CoPoS快速提升量产良率、导入终端应用市场的关键。

产业地位与市场需求推动，关税与汇率将拉抬台积电晶圆价格再上涨

7月10日科技新报消息，Wccftech报导，最新市场分析，台积电晶片价格将超越估计，调整源于台积电积极应付全球市场巨大需求，将来先进制程更不可能降价。市场初步预测5nm以下年增率约3%，CoWoS先进封装也5%年增长，为满足市场需求，台积电计划上调此二者价格。外资预估，近期新台币汇率大幅升值，涨价可能更多，因台积电将新台币升值纳入考量，以抵消毛利率影响。

格罗方德收购MIPS，涉足RISC-V处理器、加速AI与运算技术布局

7月10日科技新报消息，格罗方德 (GlobalFoundries) 宣布，已与MIPS公司签署最终协议，将正式收购这家专注于RISC-V解决方案与IP开发的企业。这笔交易将使格罗方德推出基于RISC-V 指令集架构 (ISA) 的自有处理器与其他产品，进而与部分晶圆代工客户形成竞争关系。

IBM推最新Power11晶片，有助简化AI部署

7月10日科技新报消息，IBM发布全新Power11晶片，这是自2020年来对Power晶片系列的首度重大升级，为资料中心带来更高的效能与效率。虽然每颗晶片的核心数与前一代Power10相同，不过核心效率大幅提升，还新加入了名为 “资源群组” 的韧体功能，可在不额外耗能的情况下最大化系统使用率和整体效能。

美国对日韩全面加征25%关税，记忆体供应链首当其冲

7月10日科技新报消息，美国总统Trump宣布自8月1日起对两国的所有产品课征25%进口关税。市场预期记忆体产业将受最严重冲击，因为全球绝大多数的记忆体都在日韩生产。外媒Tom's Hardware指出，美国本土企业如美光与威腾电子 (Western Digital) 的DRAM 与3D NAND晶片也多数在日本厂制造，因此也将受波及。

传苹果正在开发七款自研晶片

7月11日科技新报消息，随着iPhone 17系列与Mac、Apple Watch等多项新品下半年亮相，有开发者释出iOS 18内测版发现，苹果同步开发至少七款尚未

公开的晶片，涵盖A19、A19 Pro、M5、M5 Pro、新款Apple Watch 晶片，以及自家第二代5G 数据机C2 与一款整合蓝牙与Wi-Fi 的通讯晶片Proxima。A19 将应用于iPhone 17 Air，代号为Tilos；而A19 Pro 则对应iPhone 17 Pro 与Pro Max，代号Thera，代表高阶机型将持续采用区隔处理器设计，进一步巩固苹果硬件差异化优势。

冲破DeepSeek、关税挑战，NVIDIA市值破4兆美元

7月11日电子时报消息，NVIDIA成为全球首家市值达4兆美元的公司，巩固NVIDIA在全球科技及金融市场的霸主地位，尽管受地缘政治紧张局势和持续的晶片限制影响，NVIDIA仍受益于全球生成式AI发展的前景。

台币强升压利润，台积电2025营收9,337亿元仍达标创高

7月11日电子时报消息，受到新台币强升影响，台积电2025年6月合并营收约为新台币2,637.09亿元，较5月明显衰减17.7%，但仍较2024年同期增加26.9%，为同期新高。台积电2025年第2季营收约为9,337.92亿元，季增11.26%、年增38.65%，落在4月法说会所设下的财测区间，并创下单季新高；累计2025年上半年营收约为新台币1.77兆元，较2024年同期大幅增加40%，为历年同期新高。

四、公司公告

华海诚科：关于调整公司2024年度利润分配方案每股分配比例的公告

公司7月7日发布公告，自公司2024年年度利润分配方案披露日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施回购，公司回购专用证券账户中的股份数由391,455股增至460,567股，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，扣减公司回购专用证券账户的460,567股后，公司本次实际参与权益分派的股份数量为80,235,886股。

洲明科技：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告

公司7月7日发布公告，持有深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份268,973,418股（占公司总股本的比例为24.65%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为24.77%）的公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林洺锋先生计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月29日至2025年10月28日，以大宗交易方式减持公司股份不超过21,722,009股（占公司总股本比例1.99%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例2.00%）。

*ST华微：吉林华微电子股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

公司7月8日发布公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本960,295,304股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利38,411,812.

16元。

灿芯股份：2024年年度权益分派实施公告

公司7月8日发布公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本120,000,000股为基数，每股派发现金红利0.17元（含税），共计派发现金红利20,400,000.00元（含税）。

中富电路：2024年年度权益分派实施公告

公司7月8日发布公告，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至第二届董事会第十九次会议审议日，公司总股本为191,430,132股，以此计算合计拟派发现金红利19,143,013.20元（含税）。

木林森：2024年年度权益分派实施公告

公司7月9日发布公告，公司以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

中微半导体：2024年年度权益分派实施公告

公司7月9日发布公告，公司拟以2024年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），不进行资本公积金转增，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

至纯科技：2024年年度权益分派实施公告

公司7月9日发布公告，公司向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分配比例。

安路科技：安路科技股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告

公司7月9日发布公告，由于自身资金需求，深圳思齐将根据市场情况拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过4,008,493股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过1.00%。减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年4月8日至2025年7月7日）。

成都华微：成都华微电子科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

公司7月10日发布公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本636,847,026股为基数，每股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金红利12,736,94

0.52 元（含税）。

睿能科技：睿能科技2024年年度权益分派实施公告

公司7月10日发布公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本207,544,575股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利12,452,674.50元。

沃格光电：江西沃格光电集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

公司7月10日发布公告，本次利润分配以实施分配方案时股权登记日的总股本223,490,233股扣减公司回购账户1,858,000股，即221,632,233股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.05元（含税），共计派发现金红利11,081,611.65元（含税）。

鼎龙股份：2024年度权益分派实施公告

公司7月10日发布公告，公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。现暂以截至2024年12月31日的总股本938,282,591股为基数测算，共计派发现金股利93,828,259.10元（含税），具体以权益分派实施时股权登记日的总股本为准测算。

富创精密：2024年度权益分派实施公告

公司7月11日发布公告，公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为306,210,771股，扣除回购专用证券账户中股份总数1,666,183股，本次实际参与分配的股本数为304,544,588股，以此计算合计派发现金红利45,681,688.2元（含税）。

TCL科技：关于2024年年度权益分派实施公告

公司7月11日发布公告，以公司现有总股本18,779,080,767股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计分配利润938,954,038.35元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

影石创新：关于新增募集资金专户及授权签订募集资金专户监管协议的公告

公司7月11日发布公告，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称本次发行）4,100.00万股，发行价格为47.27元/股，募集资金总额为193,807.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为174,776.61万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月6日出具的《验资报告》（容诚验字〔2025〕518Z0066号）审验确认。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司（含子公司）已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募

集资金专户存储监管协议。

博敏电子：博敏电子关于终止股权收购框架协议的公告

公司7月11日发布公告，自签署《框架协议》以来，甲乙双方积极推进股权收购的相关工作，公司与交易对方就本次股权收购事项进行了多轮磋商。但鉴于目前甲乙双方的实际情况、标的公司未来发展预期，并结合当前的市场环境，甲乙双方未能就主要交易条款达成共识，无法签署正式的《股权转让协议》。为维护公司及全体股东的合法权益，经公司审慎研究，并经友好协商，甲乙双方于2025年7月11日签署《博敏电子股份有限公司与熊冬梅关于梅州市奔创电子有限公司股权收购意向的终止协议》，终止本次股权转让交易事项。

五、下周投资提示

表 4：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	第六届电子信息前沿论坛	7. 15	西安市	中国电子学会雷达分会
2	第七届电子与通信，网络与计算机 技术国际学术会议	7. 18-7. 20	广州市	广东工业大学自动化学院、智能检测与制造物联教 育部重点实验室
3	2025 人工智能与产品设计国际学术 会议	7. 18-7. 20	南京市	南京传媒学院
公司会议				
序号	公司名称	会议名称	会议时间	
1	弘信电子	股东大会召开	2025-07-18	
2	乐鑫科技	股东大会召开	2025-07-18	
3	芯联集成	股东大会召开	2025-07-18	
4	TCL 科技	股东大会召开	2025-07-17	
5	达瑞电子	股东大会召开	2025-07-17	
6	一博科技	股东大会召开	2025-07-17	
7	华峰测控	股东大会召开	2025-07-17	
8	万源通	股东大会召开	2025-07-17	
9	赛微电子	股东大会召开	2025-07-16	
10	卓胜微	股东大会召开	2025-07-16	
11	安克创新	股东大会召开	2025-07-16	
12	福立旺	股东大会召开	2025-07-16	
13	华映科技	股东大会召开	2025-07-15	
14	有研新材	股东大会召开	2025-07-15	
15	盛美上海	股东大会召开	2025-07-15	
16	欧菲光	股东大会召开	2025-07-14	
17	捷荣技术	股东大会召开	2025-07-14	

18	亚世光电	股东大会召开	2025-07-14
19	日久光电	股东大会召开	2025-07-14
20	航宇微	股东大会召开	2025-07-14
21	商络电子	股东大会召开	2025-07-14
22	金海通	股东大会召开	2025-07-14
23	斯达半导	股东大会召开	2025-07-14
24	晶丰明源	股东大会召开	2025-07-14
25	南亚新材	股东大会召开	2025-07-14

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表 5: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		解禁股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
688234.SH	天岳先进	2025-07-14	12,930.27	42,971.10	30,040.83	69.91	42,971.10	100.00	追加承诺限售股份上市流通
688220.SH	翱捷科技	2025-07-14	3,524.29	41,830.09	36,040.82	86.16	39,565.10	94.59	追加承诺限售股份上市流通
300576.SZ	容大感光	2025-07-15	1,085.65	36,636.76	22,179.76	60.54	23,265.41	63.50	定向增发机构配售股份
002660.SZ	茂硕电源	2025-07-21	8,229.83	35,662.60	25,708.49	72.09	33,938.33	95.17	定向增发机构配售股份
688173.SH	希荻微	2025-07-21	16,267.49	41,031.87	24,318.17	59.27	40,585.65	98.91	追加承诺限售股份上市流通
605277.SH	新亚电子	2025-07-21	238.25	32,429.73	31,567.65	97.34	31,805.90	98.08	股权激励限售股份
688545.SH	兴福电子	2025-07-22	446.02	36,000.00	6,842.33	19.01	7,288.36	20.25	首发机构配售股份
001309.SZ	德明利	2025-07-23	1,172.66	16,177.03	10,239.84	63.30	11,412.50	70.55	定向增发机构配售股份
003019.SZ	宸展光电	2025-07-23	155.24	17,639.61	16,870.49	95.64	17,025.73	96.52	股权激励限售股份
603375.SH	盛景微	2025-07-24	959.13	10,066.67	5,418.96	53.83	6,378.09	63.36	追加承诺限售股份上市流通
301123.SZ	奕东电子	2025-07-25	14,145.12	23,360.00	9,214.88	39.45	23,360.00	100.00	首发原股东限售股份
688270.SH	臻镭科技	2025-07-28	6,981.99	21,405.16	14,423.17	67.38	21,405.16	100.00	追加承诺限售股份上市流通
301606.SZ	绿联科技	2025-07-28	18,581.44	41,490.98	3,320.19	8.00	21,901.63	52.79	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份
301106.SZ	骏成科技	2025-07-28	7,243.60	10,162.13	2,918.53	28.72	10,162.13	100.00	追加承诺限售股份上市流通
688521.SH	芯原股份	2025-07-28	186.35	50,085.28	49,898.93	99.63	50,085.28	100.00	股权激励期权行

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前 金元在先

									权
300666.SZ	江丰电子	2025-07-28	15.00	26,532.07	22,105.21	83.32	22,120.21	83.37	股权激励限售股份
688130.SH	晶华微	2025-07-29	2,129.40	12,089.11	3,899.11	32.25	6,028.51	49.87	首发原股东限售股份
688652.SH	京仪装备	2025-07-31	1,686.00	16,800.00	10,221.00	60.84	11,907.00	70.88	首发原股东限售股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。